

## 非硅型导热软质厚垫片/XK- PN30

### 简介:

XK-PN 是无硅氧烷挥发材料,适用于硅敏感的应用, 比传统非硅材料有更低的硬度, 提供更高的变形量与更高的导热性质.

### 特性:

无硅氧烷挥发

高导热

高绝缘

高变形量

### 应用:

硬盘

光学精密设备



	unit	XK-PN30	Method
Color		Blue	visual
Thickness	mm	1.0~2.0	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm3	3	ASTM D792
Hardness	Asker C	8	JIS K7312
	Shore 00	30	ASTM D2240
Thermal impedance@0.5mm	°Cin2/W	0.2	ASTM D5470
Thermal Conductivity	W/mK	3	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 <sup>13</sup>	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV/mm	>10	ASTM D149
Dielectric Constant	1	7	ASTM D150
Application temperature	°C	-40~125	
Tensile strength	psi	10	ASTM D149
Elongation	%	30	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	0	GC-FID
Flammability	UL94	V-0	UL94